

论坛十七

5G 手机新材料应用论坛

2019 年 11 月 13-16 日

分论坛名誉主席：

丁文江 中国工程院院士

分论坛主席：

赵文丰 深圳市赛瑞产业研究有限公司

分论坛秘书长：

王淑萍 深圳市赛瑞产业研究有限公司

江兵华 深圳市赛瑞产业研究有限公司

F17. 5G 手机新材料应用论坛

单元 F17-1: 11 月 15 日下午

主持人: 江兵华

地点: 圣爵菲斯大酒店欢城 (金鹰厅)

13:30-13:40 F17-01

开场致辞

赵文丰

深圳市赛瑞产业研究有限公司 CEO

13:40-14:10 F17-02

5G 手机天线研究进展

沈昭元

台湾逢甲大学 特聘教授

14:10-14:40 F17-03

FCCL 软板在 5G 产业链中的未来和发展

张继贤

中山新高电子材料股份有限公司 市场部副总经理

14:40-15:10 F17-04

5G 手机及关键材料市场趋势分析

肖健

深圳市赛瑞产业研究有限公司 产业研究总监

15:10-15:30 茶歇

15:30-16:00 F17-05

5G 高频材料之低介电聚酰亚胺的研究进展

刘峰

南昌大学 教授

16:00-16:30 F17-06

5G 高频材料之 PTFE 材料

嘉宾邀请中

16:30-17:00 F17-07

5G 高频材料之 LCP 材料

嘉宾邀请中